

USB3.1C S1H DN1 RL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	OMINMATE Data – USB-Buchse, USB Buchsen, 10 Gbit/s, SMD-Lötanschluss, 90°, ≥ 10000, Raster in mm (P): 0.50 mm, Polzahl: 24, LCP, schwarz, Rolle
Best.-Nr.	2987560000
Typ	USB3.1C S1H DN1 RL
GTIN (EAN)	4099986855052
VPE	1.050 Stück
Verpackung	Rolle

Erstellungs-Datum 29. April 2024 03:24:02 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

USB3.1C S1H DN1 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	7,9 mm	Tiefe (inch)	0,311 inch
Höhe	3,21 mm	Höhe (inch)	0,126 inch
Breite	8,94 mm	Breite (inch)	0,352 inch
Nettogewicht	10 g		

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ	Nennspannung	5 V
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt	750 V AC		

Systemkennwerte

Abgangswinkel	90°	Anzahl Lötstifte pro Pol	1
Leistungs-Kategorie	10 Gbit/s	Lötstiftlänge (l)	1,15 mm
Lötverfahren	Reflow-Löten, Handlöten	Montage auf der Leiterplatte	SMD-Lötanschluss
Polzahl	24	Produktfamilie	OMINMATE Data – USB-Buchse
Raster in Zoll (P)	0,02 "	Raster in mm (P)	0,5 mm
Schirm tabs	keine	Schirmmaterial	Messing
Schirmoberfläche	vernickelt	Schirmung	360°-Schirmkontakt
Schutzart	IP20	Seitenabschluss, Eigenschaft	Keine
Steckzyklen	≥ 10000	Übertragungsrate	10 Gbit/s

Werkstoffdaten

Isolierstoff	LCP	Farbe	schwarz
Farbtabelle (ähnlich)	RAL 9011	Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Kontaktbasismaterial	Kupferlegierung	Kontaktmaterial	Gold über Nickel
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel	Betriebstemperatur, min.	-40 °C
Betriebstemperatur, max.	80 °C		

Verpackungen

Verpackung	Rolle	VPE Länge	0
VPE Breite	0	VPE Höhe	0

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01		

Downloads

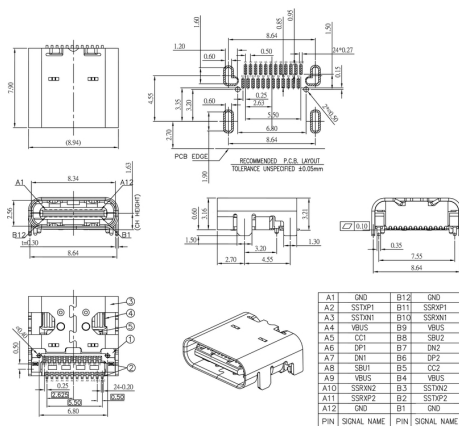
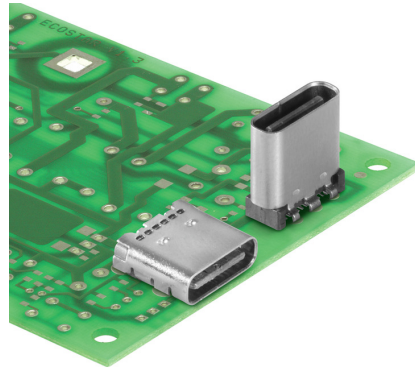
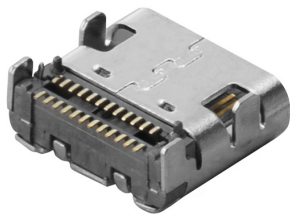
Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format

USB3.1C S1H DN1 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



A1	QND	B12	QND
A2	SSTXP1	B11	SSRXOP1
A3	SSTXN1	B10	SSRXN1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSRXN2	B3	SSTXN2
A11	SSRXOP2	B2	SSTXP2
A12	QND	B1	QND
Pin	SIGNAL NAME	Pin	SIGNAL NAME

Empfohlenes Reflow-Lötprofil**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Reflow Lötprofil**

Das ideale Temperaturprofil für die Surface Mount Technology (SMT) ist eine häufig gestellte Frage in der Produktionswelt. Eine eindeutige Antwort gibt es nicht. Der Temperatur-Zeit-Verlauf ist abhängig von den Verarbeitungseigenschaften der Lotpaste und den Belastungsgrenzen der Bauelemente.

Folgende Parameter sind zu berücksichtigen:

- Vorheizzeit
- Maximale Temperatur
- Zeit oberhalb des Pasten-Schmelzpunktes
- Abkühlzeit
- maximaler Aufheizgradient
- minimaler Abkühlgradient

Das von uns empfohlene Lötprofil beschreibt den typischen Verlauf sowie die Prozessgrenzen. In der Vorheizphase werden Platine und Bauelemente schonend vorgeheizt. Der Aufheizgradient beträgt $\leq +3$ K/s. Parallel dazu wird die Lotpaste „aktiviert“. In der Zeit oberhalb der Schmelztemperatur 217 °C wird das Lot flüssig, verbindet die Bauelemente mit den Anschlüssen auf der Platine. Dabei wird die maximale Temperatur von 245 °C bis 254 °C zwischen 10 und 40 Sekunden gehalten. In der Abkühlzeit bei ≥ -6 K/s härtet das Lot aus. Platine und Bauelemente werden nicht zu rasch abgekühlt, um Spannungsrisse zu vermeiden.